



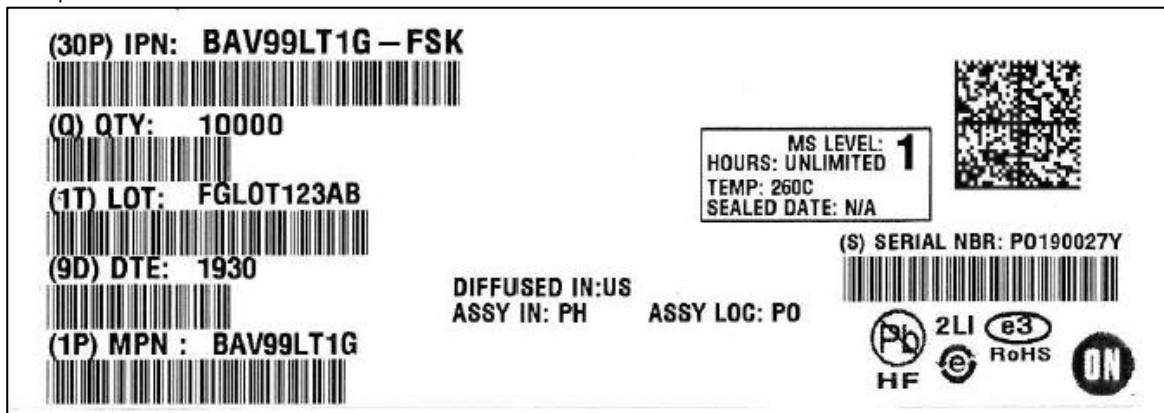
Title of Change:	ON Semiconductor MPN Label Format Change	
Effective date	01 Apr 2020	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Dusan.Zelenay@onsemi.com	
Type of notification:	ON Semiconductor considers this change approved.	
Change Category:	MPN Label information change	
Change Sub-Category(s):	Shipping/Packaging/Marking	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites
- All Internal Sites -		- All External Sites -

Description and Purpose:

ON Semiconductor will be modifying its MPN (Manufacturer Part Number) label to allow for a more flexible manufacturing process.

- ❑ There will be one new field added for ON Semiconductor's internal use only:
 - Internal Part Number (30P) – available in 1D barcode 3 of 9 and also in the 2D Barcode.
- ❑ The Manufacturer Part Number (1P) is now located at the bottom of label
- ❑ There are no changes to the data content in any field except for changes in position of the fields on the label
- ❑ This will be a phased implementation by manufacturing site. Customers may receive a combination of current and new MPN label formats for some period of time.
- ❑ Also please note there is no modification of content nor format on the CPN (Customer Part Number) label.
- ❑ For further information on the label, please refer to Packaging and Labeling Reference Manual:
<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF>

Example of new MPN label format



List of Affected Standard Parts:

This is a General Announcement. General Announcements do not contain a specific list of affected devices. ON Semiconductor uses these announcements when all or no devices are affected.

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



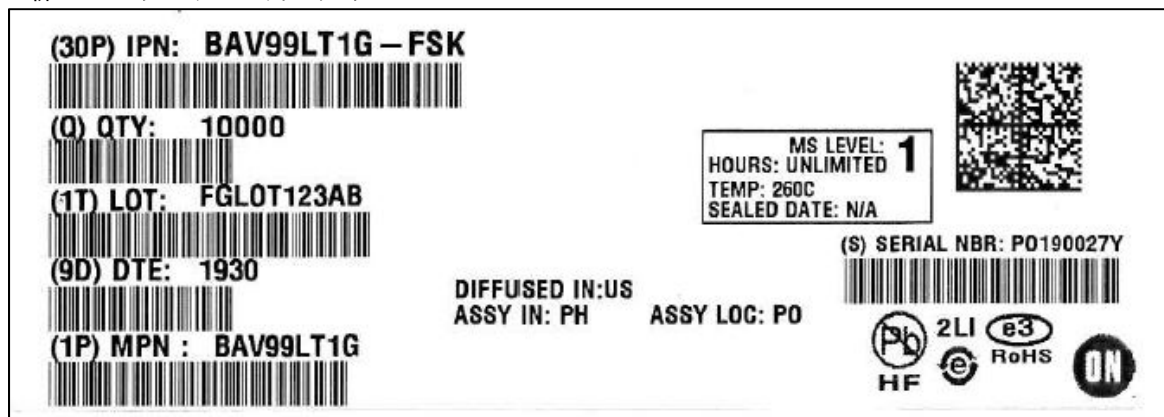
変更件名:	オン・セミコンダクターの MPN ラベルフォーマットの変更	
発効日:	1 April 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Dusan.Zelenay@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	オン・セミコンダクターは、この変更が承認されたと見なします。	
変更カテゴリ:	MPN ラベルの記載情報の変更	
変更サブカテゴリ:	出荷/梱包/マーキング	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: - 全社内拠点 -	外部製造工場 / 下請業者拠点: - 全社内拠点 -

説明および目的:

オン・セミコンダクターでは、より柔軟な製造プロセスに対応するため、MPN (Manufacturing Part Number) ラベルを変更する予定です。

- オン・セミコンダクター社内での使用のみを目的として、次のような新しいフィールドが 1 つ追加されます。
 - 社内製品番号 (Internal Part Number)(30P) - 1 次元のコード 39 バーコード、および 2 次元バーコードが利用できます。
- MPN (1P) はラベルの最下部に位置されるようになります。
- ラベル上のフィールドの位置のみが変更され、全てのフィールドのデータ内容に変更はありません。
- 今回の変更は、製造拠点ごとに段階的に実施されます。当面の間、お客様がお受け取りになる製品において現行と新しい MPN ラベルフォーマットが混在する可能性があります。
- また、CPN (Customer Part Number) ラベルについては内容もフォーマットも変更されませんので、ご注意ください。
- ラベルの詳細については、『Packaging and Labeling Reference Manual』(<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF>) を参照してください。

新しいMPNラベルフォーマットのサンプル



影響を受ける部品の一覧:

これは一般的な発表です。一般告知には、影響を受けるデバイスの特定のリストは含まれていません。オン・セミコンダクターは、すべてのデバイスが影響を受けるか、まったくデバイスが影響を受けない場合にこれらの発表を使用します。